

# 宁波江丰电子材料股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

报告期内，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZF10539 号）。现将 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务指标及其变动情况

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,601,608,568.67	2,323,878,581.81	2,325,223,350.66	11.89%	1,593,912,652.91	1,590,513,859.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	255,474,568.79	265,204,791.62	264,337,699.57	-3.35%	106,626,738.28	104,533,019.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,706,191.91	218,234,601.75	218,234,601.75	-28.65%	76,171,693.93	76,171,693.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	251,025,634.23	16,492,567.54	15,101,293.19	1,562.28%	102,906,718.42	101,969,141.66
基本每股收益（元/股）	0.96	1.11	1.11	-13.51%	0.47	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.96	1.11	1.11	-13.51%	0.47	0.46
加权平均净资产收益率	6.25%	11.41%	11.37%	-5.12%	8.77%	8.56%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	6,271,647,079.35	5,085,222,913.81	5,098,357,585.13	23.01%	2,901,436,340.37	2,922,282,227.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,174,314,633.25	4,003,258,453.87	4,006,729,778.54	4.18%	1,456,712,178.89	1,461,050,595.62

## 二、公司主营业务及其经营状况的分析

### （一）主营业务

公司主营业务为超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料的研发、生产和销售，其中超高纯金属溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属合金靶材等，这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用于制备电子薄膜材料。半导体精密零部件包括金属、陶瓷、树脂等多种材料经复杂工艺加工而成的精密零部件，主要用于半导体芯片以及平板显示器生产线的机台，覆盖了包括 PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产业机器人等应用领域，其生产过程对于材料精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高，产品主要出售给晶圆制造商作为设备使用耗材或出售给设备制造商用于设备生产。功率半导体覆铜陶瓷基板是芯片的重要载体，具有良好的导热性能、电气性能、绝缘性能以及较高的可靠性等特性，主要采用 DBC 和 AMB 生产工艺，目前覆铜陶瓷基板已经广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电子器件 IGBT 等领域，产品终端主要应用于新能源汽车、轨道交通、白色家电及绿色电力系统等众多领域。碳化硅是第三代半导体的核心材料，碳化硅外延晶片是制造功率器件的关键原材料，在新能源汽车、能源、工业等领域强劲需求的带动下，全球碳化硅器件下游需求旺盛，碳化硅外延行业市场增长迅速。

### （二）主要产品

#### 1、超高纯靶材

公司主要生产超高纯金属溅射靶材，包括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。

##### （1）超高纯铝靶材

超高纯铝及其合金是目前使用最为广泛的半导体芯片配线薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶的金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。目前，公司生产的铝靶已经广泛应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池等领域。

##### （2）超高纯钛靶材及环件

在超大规模集成电路芯片中，超高纯钛是被广泛应用的阻挡层薄膜材料之一。钛靶材及环件则是应用于 130-5nm 工艺当中，超高纯钛环件与超高纯钛靶材配套使用，其主要功能

是实现更好的薄膜性能，以达到更高的集成度要求。目前，公司生产的超高纯钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域。

### （3）超高纯钽靶材及环件

在先端的铜制程超大规模集成电路芯片中，超高纯钽是阻挡层薄膜材料。钽靶材及环件是在 90-3nm 的先进制程中必需的阻挡层薄膜材料，主要应用在最尖端的芯片制造工艺当中。因此，钽靶材及环件是靶材制造技术难度最高、品质一致性要求最高的尖端产品，在此之前仅有少数几家跨国公司能够生产。特别是钽环件生产技术要求极高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，钽靶材及环件的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。目前，公司生产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路领域。

### （4）超高纯铜靶材及环件

超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电层薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9999%（6N）以上，平板显示器、太阳能电池用铜靶的金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。铜及铜合金作为导电层通常用于 90-3nm 技术节点的先端芯片中。特别是铜锰合金靶材制造难度高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，铜锰合金靶材的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。公司生产的铜及铜合金靶主要用于超大规模集成电路芯片和平板显示器制造领域。

## 2、精密零部件

半导体精密零部件是半导体设备制造中难度较大、技术含量较高的环节，作为半导体设备核心技术演进的关键，半导体精密零部件具有精度高、多品种、小批量、尺寸特殊、工艺复杂、要求严苛等特性，主要应用于高端半导体刻蚀、沉积、离子注入等设备，主要包括传输腔体、反应腔体、腔体、圆环类组件（ring）、腔体遮蔽件（shield）、保护盘体（disc）、冷却盘体（cooling arm）、加热盘体（heater）、气体分配盘（shower head）、气体缓冲盘（block plate）、模组组件等；材料包括金属类（不锈钢、铝合金、钛合金）、非金属类（陶瓷、石英、硅、高分子材料）等；制造工艺包括超精密加工、扩散焊、氩弧焊、真空钎焊、表面处理、阳极氧化、等离子喷涂、热喷涂、特殊涂层、超级净化清洗等。在芯片先进制程生产工艺中，各种精密零部件作为耗材被广泛使用，零部件产品对金属材料精密制造技术、

表面处理特种工艺等技术要求极高。目前，公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片领域。

### 3、其他产品

除上述超高纯金属溅射靶材以及精密零部件产品以外，公司生产的其他产品包括第三代半导体基板材料、碳化硅外延片、LCD 用碳纤维复合材料部件等其他产品和对外提供的清洗、加工等服务。

## （三）主要经营模式

### 1、采购模式

公司依据销售订单和生产计划制定具体的采购计划，结合主要原材料的现有库存量、采购周期、在途时间等因素计算具体的采购数量，并确保一定的安全库存量。对于主要原材料的采购，公司已经建立了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商结成了长期稳定的战略合作伙伴关系，根据制定的采购计划实施采购；对于其他原材料的采购，公司通常会选择 2-3 家合格供应商，建立多家供货渠道，经询价后确定供应商并及时采购入库。针对日本供应商，公司主要通过全资子公司日本江丰直接采购，以及日本江丰通过三菱化学旗下的综合商社向其采购高纯金属原材料。

### 2、生产模式

由于公司的终端用户多为世界一流芯片制造企业，各客户拥有独特的技术特点和品质要求，为此公司根据客户的个性化需求采取了定制化的生产模式。研发生产的产品在材料、成分、形状、尺寸、性能参数等诸多方面存在着不同，公司生产具有“多品种、小批量”的特点。在产品研发及设计前期，公司要投入大量精力与终端客户进行技术、品质、性能的交流，当产品通过客户评价后，生产部门在接到来自销售部门的客户订单后，即根据订单制定生产计划，实行“以销定产”的生产模式。

公司已经掌握了超高纯金属溅射靶材生产中的核心技术，形成了晶粒晶向控制、材料焊接、精密加工、产品检测、清洗包装等在内的完整业务流程，通过合理调配机器设备和生产资源自主组织生产，实行柔性化生产管理。在先进制程领域，公司持续适应下游客户不同的技术路线演变需求和变革需求，从而实现先进制程领域超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产。

### 3、销售模式

由于超大规模集成电路、平板显示器、太阳能电池等下游客户对溅射靶材的产品质量、性能指标等有着较为严苛的要求，因此，公司下游客户存在严格的供应商和产品认证机制。

公司与潜在客户初步接触之后，需要经过供应商初评、产品报价、样品检测、小批量试用、稳定性检测等认证程序之后，才能成为合格供应商并批量供货。

公司与客户的销售模式包括直销和商社代理销售模式。直销模式下，公司及公司的具体产品通过了客户认证评价后，由客户向公司下达月度或季度订单，公司按约定的交货期向客户发货。商社代理模式则是指公司的日本终端客户通过知名商社向公司采购产品的模式。该模式在日本制造业企业中较为普遍，其业务流程为最终客户首先与综合商社签订采购合同，综合商社再与公司签订合同，公司按照合同要求发货至综合商社指定仓库，由综合商社向公司支付货款。公司全资子公司日本江丰成立后，公司日本终端客户也可以通过日本江丰直接向公司采购。

公司采用目前的经营模式是根据超高纯金属溅射靶材、精密零部件以及第三代半导体关键材料产品原材料供应情况、生产工艺、公司所处行业市场竞争格局确定的，报告期内未发生重大变化。报告期内，公司的主营业务一直专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件以及第三代半导体关键材料的研发、生产和销售，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

#### （四）主要的业绩驱动因素

##### 1、集成电路行业发展前景良好

芯片是现代信息社会的基石，人工智能、移动通信、数据中心和云计算服务器、虚拟现实等都是芯片的终端应用领域。在以 AI 技术为代表的人工智能、高性能算力强劲需求的引领下，芯片市场将出现长期的强力增长，全球集成电路产业未来将持续向好，带动上游材料和设备零部件的市场空间持续扩容，是公司业绩增长的正向驱动力。

##### 2、超高纯靶材全球市场均衡发展

全球集成电路产业受全球经济波动及行业周期等多重因素交叠影响，市场供需关系呈现结构性和多样性，某些应用的需求紧缺仍在持续。公司长期深耕半导体用超高纯金属溅射靶材领域，积攒了技术、经验和客户优势，抓住了国内外市场发展机遇，布局多品类产品，在全球超高纯金属溅射靶材应用市场、全产业链均衡发展，满足国际和国内客户需求，提升全球市场占有率。

##### 3、精密零部件产品加速放量

公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材积累的技术、经验及客户优势，同时借助于现有的成熟管理体系和文化体系，为公司拓展半导体精密零部件业务奠定了良好基础。公司

抢占市场先机，加大自主创新和研发力度，迅速拓展在精密零部件领域的产品线，公司精密零部件产品加速放量。

#### 4、第三代半导体关键材料市场前景广阔

随着新能源车、轨道交通、特高压、5G 通讯等新兴领域的高速发展，功率半导体芯片封装核心散热基板的需求将呈现爆发式增长，覆铜陶瓷基板市场前景广阔；同时碳化硅器件下游需求旺盛，碳化硅外延行业市场增长迅速。

#### （五）报告期主要经营情况

2023 年，尽管受到全球经济环境、半导体行业周期等外部因素影响，但公司不畏艰难，积极扩大全球市场份额，加大技术创新和研发投入，不断推出新产品推进产品迭代升级和生产工艺创新，构建安全稳定供应链，积极拓展战略性业务布局，形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料为核心的三大业务主线，实现业务快速发展。报告期内，公司实现营业收入 26.02 亿元，同比增长 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，同比下降 3.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.56 亿元，同比下降 28.65%。公司完成的主要工作如下：

##### 1、超高纯靶材销售规模逆势增长，全球化战略布局加速推进

公司持续加大研发投入和装备扩充，积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目，并且充分发挥龙头企业的牵引作用，成功构建安全稳定的供应链体系，产业链护城河不断拓宽。同时，公司持续追踪客户需求，以行业领先的高品质产品为全球客户提供综合解决方案，加强市场渗透、扩大市场份额，销售规模逆势增长，公司铜锰合金靶材已经在国内外量产，全面进入国际著名芯片制造企业。报告期内，超高纯靶材实现销售收入 16.73 亿元，同比增长 3.79%。

2023 年 10 月，韩国孙公司 KFAM CO., LTD. 完成登记注册，计划在韩国新建一座现代化的半导体靶材生产工厂，韩国生产基地的建设有助于公司实现全球化战略布局，提高产品的市场占有率和国际竞争力，保证半导体材料全球供应链的稳定性。

##### 2、半导体精密零部件快速成长，产品组合不断丰富

随着半导体生产制造设备国产替代持续推进，带动了半导体精密零部件行业的发展，作为半导体设备核心技术演进的关键，半导体精密零部件具有广阔的市场前景。公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材积累的技术、经验及客户优势，实现了半导体精密零部件业务的快速成长。报告期内，公司积极推动余姚、上海、杭州、沈阳等基地的产能建设，全面布局金属和非金属类半导体精密零部件，气体分配盘（Shower head）、Si 电极等核心功能零部件迅速放量，填补了国产化空白，为工艺设备上游的零部件国产化做出了重要贡献，市场

认可度不断提高。报告期内，半导体精密零部件业务实现销售收入 5.70 亿元，同比增长 58.55%。

### 3、第三代半导体产品取得进展

公司紧跟国家第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿，已经在第三代半导体材料领域取得进展。

控股子公司宁波江丰同芯的主要产品高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可，可广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电子器件 IGBT 等领域。控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司生产的碳化硅外延片产品已经得到多家客户认可，为我国碳化硅产业链的蓬勃发展注入新动能。

### 4、研发创新持续保持技术领先性

2023 年，公司承担的国家电子信息产业发展专项顺利通过验收，公司的“平板显示用超高纯铝、铜溅射靶材关键技术研究及产业化”项目获得 2022 年度宁波市科学技术进步奖一等奖，公司获得浙江省首届知识产权三等奖；公司的研发平台之一“浙江省企业研究院”晋升为“浙江省重点企业研究院”，并获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省科技领军企业”的荣誉；此外，公司及子公司合肥江丰电子材料有限公司、宁波江丰热等静压技术有限公司再次被认定为高新技术企业，子公司宁波江丰钨钼材料有限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、上海睿昇半导体科技有限公司首次被认定为高新技术企业，公司和上述子公司的技术实力及研发水平被得到充分肯定。

报告期内，公司研发费用投入达 1.72 亿元，同比增长 37.87%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共取得国内有效授权专利 784 项，包括发明专利 482 项，实用新型 302 项。另外，公司取得韩国发明专利 4 项、中国台湾地区发明专利 1 项、日本发明专利 2 项。

### 5、加快整体数字化转型升级和推进智能制造

报告期内，公司完成了 ERP 系统升级和黄湖未来工厂规划项目。黄湖未来工厂规划项目经过科学的物理和数字化规划，确定了工厂详细布局、自动仓储物流、31 项自动化生产线、智慧园区等初步方案，以及数字化整体技术和集成架构，经过层层遴选，该项目进入“2023 年浙江省未来工厂试点企业”名单；此外，公司已累计投产运行多条自动化产线，有效提升了生产效率。上述成果将加快公司整体数字化转型升级和推进智能制造，助力公司数字化赋能生产运营迈上新台阶，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

### 6、持续推进产品质量管理创新

公司始终秉承“品质成就未来”的信条，坚持走质量创新与提升之路。报告期内，公司凭借在半导体材料产业链的全面布局、实施卓越绩效管理，以及在质量创新、标准创新、品牌建设和知识产权创造等方面取得的成效，获得“第九届浙江省人民政府质量管理创新奖”；公司的《应用防错手段达成品质零缺陷》案例入选“2023 年中国电子信息行业质量提升典型案例”，本案例通过实施靶材加工零缺陷质量保障创新方法，建立全过程质量信息感知和处理系统，建设实验室管理系统与数字化产品全生命周期质量追溯，有效保障公司产品质量的稳定性，有利于公司获得良好的质量收益并提升客户满意度。目前，公司已经在研发、技术、采购、生产及客户服务全过程形成持续的改进创新闭环，为公司实现技术节点跟随全球先进制程进行迭代、高品质与可持续的发展提供坚实的质量保障。

#### 7、持续完善公司治理，回购公司股份提振投资者信心

报告期内，公司持续完善公司治理，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报投资者，主动履行社会责任。年度内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，加强、充实了高级管理团队。同时，公司荣获深圳证券交易所信息披露考评 A 级评价；荣登“创业板上市公司价值 50 强”榜单；入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”，树立了良好的资本市场形象。

此外，公司于 2023 年 9 月发布《关于回购公司股份方案的公告》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）回购公司股份，将用于股权激励或员工持股计划。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户回购公司股份 341,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.1285%，支付的总金额为人民币 19,991,828.00 元（不含交易费用）。

公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心，有利于提振投资者的信心。

#### （六）营业收入情况

##### 1、营业收入整体情况

单位：人民币元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,601,608,568.67	100%	2,325,223,350.66	100%	11.89%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,601,608,568.67	100.00%	2,325,223,350.66	100.00%	11.89%



分产品					
超高纯靶材	1,672,565,552.06	64.29%	1,611,430,054.13	69.30%	3.79%
精密零部件	570,121,065.79	21.91%	359,594,338.06	15.47%	58.55%
其他	358,921,950.82	13.80%	354,198,958.47	15.23%	1.33%
分地区					
内销	1,457,244,702.34	56.01%	1,061,091,720.39	45.63%	37.33%
外销	1,144,363,866.33	43.99%	1,264,131,630.27	54.37%	-9.47%
分销售模式					
直销	2,509,748,411.68	96.47%	2,205,827,080.87	94.87%	13.78%
代理	91,860,156.99	3.53%	119,396,269.79	5.13%	-23.06%

## 2、占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,601,608,568.67	1,841,876,905.36	29.20%	11.89%	12.98%	-0.69%
分产品						
超高纯靶材	1,672,565,552.06	1,196,733,607.72	28.45%	3.79%	6.67%	-1.93%
精密零部件	570,121,065.79	415,723,925.26	27.08%	58.55%	51.15%	3.56%
其他	358,921,950.82	229,419,372.38	36.08%	1.33%	-1.69%	1.96%
分地区						
内销	1,457,244,702.34	1,052,821,170.44	27.75%	37.33%	48.37%	-5.38%
外销	1,144,363,866.33	789,055,734.92	31.05%	-9.47%	-14.30%	3.88%
分销售模式						
直销	2,509,748,411.68	1,773,430,045.36	29.34%	13.78%	15.52%	-1.07%
代理	91,860,156.99	68,446,860.00	25.49%	-23.06%	-28.08%	5.20%

## 三、公司资产、费用同比发生重大变动的说明

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	958,947,321.80	15.29%	1,315,414,843.09	25.80%	-10.51%	主要系上年同期收到公司向激励对象授予限制性股票及定向增发的募集资金，报告期内购买土地使用权、设备、

						支付工程款增加及对外投资增加所致。
应收账款	665,331,836.45	10.61%	442,725,860.10	8.68%	1.93%	主要系报告期内公司营业收入持续增长所致。
存货	1,090,400,655.05	17.39%	1,060,151,788.19	20.79%	-3.40%	
投资性房地产	64,684,719.36	1.03%	28,108,631.58	0.55%	0.48%	主要系报告期内出租房屋增加所致。
长期股权投资	270,648,296.49	4.32%	225,364,220.98	4.42%	-0.10%	
固定资产	1,063,659,405.79	16.96%	848,459,045.69	16.64%	0.32%	主要系报告期内购买设备、在建工程转入增加所致。
在建工程	950,627,727.43	15.16%	335,284,036.02	6.58%	8.58%	主要系报告期内厂房的建设及装修工程增加所致。
使用权资产	58,422,100.07	0.93%	43,070,852.81	0.84%	0.09%	
短期借款	185,173,784.73	2.95%	156,645,792.97	3.07%	-0.12%	
合同负债	8,340,408.66	0.13%	1,286,094.78	0.03%	0.10%	
长期借款	749,980,000.00	11.96%	209,177,555.54	4.10%	7.86%	主要系报告期内增加长期银行融资所致。
租赁负债	34,496,102.97	0.55%	27,544,319.74	0.54%	0.01%	
预付款项	33,924,730.41	0.54%	19,893,400.74	0.39%	0.15%	主要系报告期内预付货款增加所致。
其他应收款	34,063,355.03	0.54%	25,005,139.63	0.49%	0.05%	主要系报告期末应收出口退税额增加所致。
其他流动资产	71,466,609.46	1.14%	41,218,749.56	0.81%	0.33%	主要系报告期末增值税留抵增加所致。
其他非流动金融资产	285,882,800.23	4.56%	106,465,589.34	2.09%	2.47%	主要系报告期内公司对外投资芯联集成电路制造股份有限公司等增加所致。
长期待摊费用	128,388,166.49	2.05%	58,536,862.50	1.15%	0.90%	主要系报告期内经营租赁的厂房装修等工程完工所致。
应付账款	835,981,572.85	13.33%	422,553,643.65	8.29%	5.04%	主要系报告期内应付工程款增加所致。
其他应付款	48,419,815.13	0.77%	107,483,495.48	2.11%	-1.34%	主要系报告期内限制性股票回购义务减少所致。
一年内到期的	91,282,339.45	1.46%	34,493,228.46	0.68%	0.78%	主要系一年内

非流动负债						到期的长期借款增加所致。
库存股	65,092,250.00	1.04%	95,697,000.00	1.88%	-0.84%	主要系报告期内限制性股票部分解禁，回购公司股份增加所致。

## 2、费用变化情况

单位：人民币元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	87,620,009.88	77,457,599.01	13.12%	
管理费用	226,750,374.30	190,494,352.51	19.03%	
财务费用	-16,727,266.91	7,418,182.03	-325.49%	主要系上年同期增加了可转债利息所致。
研发费用	171,764,895.37	124,586,273.40	37.87%	主要系报告期内公司持续增加研发投入所致。

## 四、现金流量变动的说明

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,507,962,685.82	2,525,092,211.40	-0.68%
经营活动现金流出小计	2,256,937,051.59	2,509,990,918.21	-10.08%
经营活动产生的现金流量净额	251,025,634.23	15,101,293.19	1,562.28%
投资活动现金流入小计	57,592,100.00	95,686,402.95	-39.81%
投资活动现金流出小计	1,083,681,925.62	942,536,149.59	14.98%
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,089,825.62	-846,849,746.64	-21.17%
筹资活动现金流入小计	1,470,597,926.59	3,917,607,900.18	-62.46%
筹资活动现金流出小计	1,057,803,895.46	2,290,613,706.44	-53.82%
筹资活动产生的现金流量净额	412,794,031.13	1,626,994,193.74	-74.63%
现金及现金等价物净增加额	-355,775,567.30	826,141,349.78	-143.06%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2023 年度较上年同期增加 23,592.43 万元，增幅为 1,562.28%。主要系公司逐步推进原材料国产化，加强库存周转管理，合理控制生产备货所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2023 年度较上年同期减少 17,924.01 万元，降幅为 21.17%。主要系报告期内购买土地使用权、设备、支付工程款增加及对外投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2023 年度较上年同期减少 121,420.02 万元，降幅为 74.63%。主要系上年同期公司向激励对象授予限制性股票、股票期权员工行权及定向增发的募集资金所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：2023 年度较上年同期减少 118,191.69 万元，降幅为 143.06%。主要系上年同期公司向激励对象授予限制性股票、股票期权员工行权及定向增发的募集资金，报告期内经营活动现金流量净额增加，投资活动现金流量净额减少所致。

## 五、利润分配情况

根据公司2024年4月23日第四届董事会第五次会议决议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以2023年12月31日公司股份总数265,435,583股扣除回购专用证券账户中已回购股份341,100股后的股本265,094,483股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币53,018,896.60元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若2024年1月1日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因股权激励授予股份回购注销等原因发生变动及公司增加回购股份数量的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份（尚未用于股权激励或员工持股计划）的可分配股份总数为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日